公司代码：688396　　公司简称：华润微

华润微电子有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7373元（含税），预计派发现金红利总额为97,330,372.91元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴国屹	邓加兴
办公地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司制造与服务业务主要提供半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。此外，公司还提供掩模制造服务。

(二)主要经营模式

公司产品与方案板块业务目前主要采用IDM经营模式，同时制造与服务板块业务向国内外半导体企业提供专业化服务。

IDM模式是指包含芯片设计、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式。公司产品及方案板块采用IDM经营模式，主要原因为IDM模式在研发与生产的综合环节长期的积累会更为深厚，有利于技术的积淀和产品群的形成。另外，IDM企业具有资源的内部整合优势，在IDM企业内部，从芯片设计到制造所需的时间较短，不需要进行硅验证，不存在工艺对接问题，从而加快了新产品面世的时间，同时也可以根据客户需求进行高效的特色工艺定制。功率半导体领域由于对设计与制造环节结合的要求更高，采取IDM模式更有利于设计和制造工艺的积累，推出新产品速度也会更快，从而在市场上可以获得更强的竞争力。该模式对企业技术、资金和市场份额要求较高。公司主要经营模式如下：

1、产品与方案业务板块

（1）研发模式

针对产品与方案板块的开发，公司制定流程控制文件《新产品开发控制程序》。研发流程主要包括立项、设计、样品试制及评价、试生产和量产五个阶段，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。

①立项阶段：综合考量市场调研、客户需求、技术趋势等因素启动产品立项，立项评估报告包括市场可行性、技术可行性、工艺及生产可行性、财务可行性、项目计划及预算等方面。评估报告提交评审委员会评议通过后进入设计阶段。

②设计阶段：产品立项后，研发人员依据《设计开发技术评估报告》和《设计开发任务书》正式进入产品设计阶段，其中包括线路设计、版图设计、工艺设计及验证方案等步骤。在设计过程中，需要时可根据产品规模、设计难度等进行次数不定的设计审查。研发人员会围绕设计目标，进行芯片仿真、失效模式分析，确定产品的雏形，初步确定材料规格及工艺流程，进行单项工艺开发。产品设计方案经委员会评审通过后，将根据方案制作相应光刻版，准备工程批流片试验。

③样品试制及评价阶段：该阶段将依据产品性能与功能要求选择合适的设计验证流程。工程试验批在流通后对芯片进行中测评价与封装成品测试评价，若不达标则进行新一轮的工艺调整或版图调整，直至相关参数达标，同时进行可靠性评价、无有害物质评价、应用评价以及客户送样评价。样品通过上述全部评价后，进行扩批验证稳定性。在完成工艺流程固化、关键窗口拉偏完成、可靠性考核、客户认定通过等程序后，样品提交评审委员会评审，通过后进入试生产阶段。

④试生产阶段：研发人员继续优化改进产品，提升产品的良率，及时解决客户反馈，在达到一定产量后提交评审委员会评审，通过后进入量产阶段。

⑤量产阶段：运营中心按订单计划安排生产，工厂按照流程单、控制计划进行生产，在生产过程中各部门持续协同改进，通过技术革新与产品升级不断提升客户满意度。

（2）采购和生产模式

产品与方案板块依托公司全产业链制造资源，主要采取IDM经营模式经营，同时根据实际需要，对少量阶段性产能或工艺不匹配的生产环节选择进行外协加工生产。

IDM模式下，市场部门根据市场及客户需求制订销售计划，综合计划部根据销售计划制定生产计划，晶圆生产由公司制造中心完成，制造中心会根据内外部整体需求进行原材料采购计划。晶圆生产完成后通过公司封测平台进行封装测试。如有需要外协加工的情况，公司在严格遴选委外供应商的基础上，严格管理和跟踪外协加工全过程，保证产品的质量和性能要求，同时高度重视核心技术的保密工作。

（3）销售模式

公司产品与方案板块采取直销与经销相结合的模式，公司制定了《营销业务管理规定》《经销商通用规则》《市场部订单管理规定》等制度，具体规定和流程如下：

①接受订单与计划：市场部门将客户订单录入系统，包括产品规格型号、订购数量、价格、交货日期等，市场部门与运营中心根据库存情况确认可达成的交期，确认后对客户进行回复。市场部门根据客户提供的计划，提交运营中心，由运营中心按照需求组织制造生产。

②发货：对于款到发货的客户，公司确认收到客户的付款单后进行发货；对于授信客户，在授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

③开具发票：发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后将发票发送客户。

④对账及收款：公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

公司产品的终端客户数量众多，部分销售需要通过经销商提供销售渠道以及日常的客户维护工作。公司选定的经销商具有丰富的销售网络及深厚的客户积累，是公司客户的重要组成部分。公司对经销商管理建立并执行全套的严格管理措施，经销商需提供终端客户资料，签订《经销商通用规则》《销售协议书》，再进行送样、报价、接单交易，公司会不定期对经销商进行实地拜访和核实。公司一般通过经销区域范围、客户资源、推广能力、技术支持、资金实力等方面综合考察经销商。公司主要经销商皆为行业内知名经销商，具有较强的营销管理能力，同时自身的技术水平和团队也能为终端客户提供一定的售前和售后技术支持服务，从而有效地满足终端客户的需求。

2、制造与服务业务板块

（1）研发流程

公司制造与服务板块工艺技术研发遵循业界标准的研发流程，具体包括立项评估、工程开发、产品验证、试生产、量产等重要环节，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。公司制造与服务板块工艺技术研发简要流程如下：

①立项评估阶段：市场部门根据市场及客户发展需求以及公司产品发展战略需求，确立工艺技术发展目标，在公司内产、销、研等部门展开全面立项评估，针对市场、商业、技术、生产、财务等维度进行量化打分，最终由评审委员会进行评议后确定是否立项，并明确项目目标与负责人。

②工程开发阶段：基于立项需求及项目目标，项目负责人在公司范围内成立项目团队，规划项目开展计划与配套资源，组织实施项目研发工作。以晶圆制造为例，具体技术开发流程包括工艺物理设计规则文件定义、工艺流程架构定义、器件架构及参数目标定义、工程开发阶段工程掩模版的规划与制作、工程试验方案的制定与流片、工艺及器件开发结果测试与评价等工作。工艺及器件开发达标后，研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审阶段技术交付。通过技术评审后，由市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一开发阶段。

③产品验证阶段：基于工程开发阶段交付，由研发中心完成器件模型参数提取与设计服务套件文件建立，并提交给设计单位进行相应产品设计。产品导入后由研发中心开展产品工程流片并保证工艺及器件参数达标。产品功能验证评价由设计单位负责，研发中心配合进行工程改善以及产品工程窗口验证。产品验证达标后，由研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审技术交付。通过技术评审后，市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否具备进入试生产阶段的条件。

④试生产阶段：通过工艺平台可靠性考核及客户产品可靠性考核，客户产品进入小批量生产阶段。该阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等工作。产品试生产各项交付指标达标后，研发中心负责总结阶段成果，并提交评审委员会评审。通过技术评审后，公司结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一阶段。

⑤量产阶段：运营中心主要负责产品生产，并管控产品良率提升、生产能力改进、生产效率提升等工作，使研发效益最大化。

（2）采购模式

公司制造与服务板块主要采用“以产定采”的采购模式。晶圆制造服务主要采购原材料有硅片、化学品等；封装测试服务主要采购原材料有引线框、塑封料等。同时，公司采购部门会根据市场供应情况、价格变化情况及供应商交货周期等因素，结合生产计划对主要的原材料，进行适当的安全库存备货。

公司采购方式分为招标采购方式和非招标采购方式，公司经过多年发展，已和多数主要原材料供应商建立了良好的合作关系，建立了合格供应商名录，采购部门按采购计划在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。采购部门会根据采购类别和采购金额选择相应的采购方式，并与供应商签订相应的采购合同，内容包括采购金额、数量和供货日期等，货物经质检验收后入库。

（3）生产模式

公司具备完善的生产运营体系，由运营中心综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划。

对于晶圆制造业务，在接到客户的产品订单后，公司首先根据客户的需求确定客户产品所需的制程、规格并制定工艺路线和工艺流程等相关资料。综合计划部负责制造生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产系统方面的技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造部门负责落实生产。对于新客户或是新产品，制造中心与研发中心将协同公司相关部门进行立项评审，确定产品开发项目及相关的工艺路线、工艺流程，安排流片实验并完成相关的技术测试分析、封装测试分析、客户试用评估、可靠性考核评估等新品综合实验。通过客户验证评估后，公司对新产品进行试生产、小批量生产以评估产品的稳定性、一致性以及是否具备量产所需的工艺窗口。通过这些验证后，产品可以开始根据客户需求进入量产。公司质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

对于封装测试业务，公司生产流程如下：客户有新产品封装测试需求，公司将先评估封测是否能承接并安排工程试验批，流程通过后进入量产阶段。客户提供封测代工需求计划，综合计划部依据产能情况评估计划承接量。公司在接到客户订单并收到客户圆片后，进行生产安排，并负责管理订单交期确认、生产计划安排、订单交付等事项。在具体的生产过程中，综合计划部负责封测生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产支持系统方面等技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造中心负责落实生产，质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

（4）销售模式

目前公司制造与服务板块以直销作为主要销售方式，由市场部门负责销售管理，公司制造与服务板块主要客户是半导体企业，公司与国内众多半导体企业建立了稳定的合作关系，并与其在产品交期、质量控制、交货方式、付款方式等方面形成了标准化、系统化、合同化约束，客户一般会与公司签订框架性合同，根据具体的生产计划以订单方式向公司发出采购计划，公司生产完成后发货。发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后将发票发送客户。公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。半导体是电子产品的核心，信息产业的基石。半导体行业具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展，如2011年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》、2017年工信部颁布的《物联网“十三五”规划》、2020年8月4日，国务院颁布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇，预计中国集成电路产业依然保持快速增长态势。

随着物联网、5G通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。全球集成电路行业市场规模大且保持较快增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2020年全球半导体市场销售额为4,390亿美元，同比增长了6.5%。根据IBS数据，未来五年，半导体行业将迎来一波快速增长，预计2022年市场规模突破5,000亿美元，2024年将达到6,060亿美元。到2030年，全球集成电路产业规模预计达到1万亿美金。

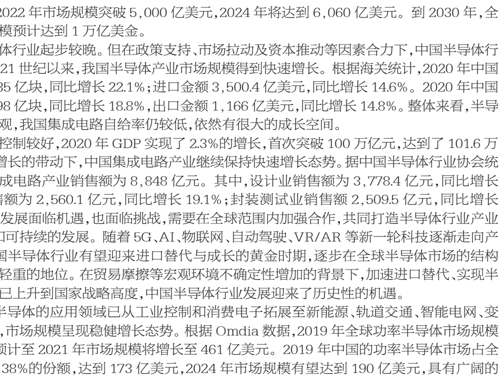
我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。步入21世纪以来，我国半导体产业市场规模得到快速增长。根据海关统计，2020年中国进口集成电路5,435亿块，同比增长22.1%；进口金额3,500.4亿美元，同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2,598亿块，同比增长18.8%，出口金额1,166亿美元，同比增长14.8%。整体来看，半导体市场增长前景可观，我国集成电路自给率仍较低，依然有很大的成长空间。

我国由于疫情控制较好，2020年GDP实现了2.3%的增长，首次突破100万亿元，达到了101.6万亿元。在中国经济增长的带动下，中国集成电路产业继续保持快速增长态势。据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元。其中，设计业销售额为3,778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2,560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2,509.5亿元，同比增长6.8%。半导体行业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造半导体行业产业链，实现更加健康和可持续的发展。随着5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

近年来，功率半导体的应用领域已从工业控制和消费电子拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场，市场规模呈现稳健增长态势。根据Omdia数据，2019年全球功率半导体市场规模约为456亿美元，预计至2021年市场规模将增长至461亿美元。2019年中国的功率半导体市场占全球功率半导体市场38%的份额，达到173亿美元，2024年市场规模有望达到190亿美元，具有广阔的国产替代空间。随着国家政策为大陆半导体行业创造了良好的发展环境及半导体产业重心向中国的转移，中国功率半导体行业有望率先实现国产替代，进入高速发展的黄金时期。中国功率半导体企业有望在消费电子、工业控制、汽车电子等领域实现依次突破，国产替代进程正不断加速。

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体分为功率IC和功率分立器件两大类，功率分立器件主要包括二极管、晶闸管、晶体管等产品。

功率半导体产品范围示意图



2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。经过多年发展及一系列整合，公司是目前国内领先的运营完整产业链的半导体企业。

公司是中国本土领先的以IDM模式为主经营的半导体企业，同时也是中国最大的功率器件企业之一。在功率半导体领域，公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中，MOSFET是公司最主要的产品之一，公司是国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。公司是目前国内少数能够提供-100V至1500V范围内低、中、高压全系列MOSFET产品的企业，也是目前国内拥有全部主流MOSFET器件结构研发和制造能力的主要企业，生产的器件包括沟槽栅MOS、平面栅VDMOS及超结MOS等，可以满足不同客户和不同应用场景的需要。根据Omdia的统计，2019年度以销售额计，公司在中国MOSFET市场中排名第三，仅次于英飞凌和安森美，是中国本土最大的MOSFET厂商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）第三代半导体材料带来发展新机遇

半导体行业经过近六十年的发展，目前已经发展形成了三代半导体材料，第一代半导体材料主要是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料是宽禁带半导体材料，其中最为重要的就是SiC和GaN。和传统半导体材料相比，更宽的禁带宽度允许材料在更高的温度、更强的电压与更快的开关频率下运行。SiC具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点，使得其器件适用于高频高温的应用场景，相较于硅器件，可以显著降低开关损耗。因此，SiC可以制造高耐压、大功率电力电子器件如MOSFET、IGBT、SBD等，用于智能电网、新能源汽车等行业。与硅元器件相比，GaN具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点，是超高频器件的极佳选择，适用于5G通信、微波射频等领域的应用。未来，随着第三代半导体材料的成本因生产技术的不断提升而下降，其应用市场也将迎来爆发式增长，给半导体行业带来新的发展机遇。根据Omdia数据，2019年SiC应用市场规模约6.5亿美元，受新能源汽车行业庞大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等领域对于效率和功耗要求提升的影响，预计到2025年SiC应用市场规模将超过24亿美元，2019-2025年的复合增速接近24%。

（2）新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

随着物联网、5G通信、人工智能等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。如在汽车电子领域，相比于传统汽车，新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路，新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍，同时功率半导体用量比例也从20%提升到近50%。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业将会出现发展的新契机。

（3）先进封装技术的升级迭代与创新

随着半导体产业进入后摩尔时代，制造端的成本不断上升，产品功能集成更加复杂，因此得益于对更高集成度的广泛需求，以及下游5G、消费类、存储和计算、物联网、人工智能和高性能计算等大趋势的推动，先进封装将成为推进封装产业的主推动力。根据Yole的预测，2018-2024年，先进封装市场的年复合增长率将达到8%，到2024年达到近440亿美元。虽然中国本土供应商在传统封装领域已占据较高比例的全球市场份额，但在先进封装领域仍需持续提升国际竞争力，2020年我国先进封装占全球市场比例预计约为14.8%，仍有较大的提升空间。先进封装技术的演进，一方面提升封装测试环节在半导体制造产业链中的地位与价值量，另一方面也给现有市场格局带来了新技术要求的挑战。先进封装包括倒装芯片（FC）、硅通孔（TSV）、嵌入式封装（ED）、扇入（Fan-In）/扇出（Fan-Out）型晶圆级封装、系统级封装（SiP）等先进技术演进形式，相较于传统封装技术能够保证质量更高的芯片连接以及更低的功耗。其中，扇出型封装技术是顺应半导体产品小型化、薄型化、功能强而发展起来的新一代封装技术，是封装技术最重要的发展方向之一。面板级封装（PLP）是一种从晶圆和条带级向更大尺寸面板级转换的方案。由于其潜在的成本效益和更高的制造效率，吸引了市场的广泛关注，该技术有望带来了相较传统封装更高规模的经济效益，并且能够实现大型封装的批量生产。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	16,532,495,766.97	10,095,287,650.34	63.76	9,992,053,434.32
营业收入	6,977,259,188.03	5,742,784,130.70	21.50	6,270,796,546.92
归属于上市公司股东的净利润	963,661,634.37	400,755,536.42	140.46	429,441,345.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,147,747.43	206,311,510.92	313.52	322,189,448.00
归属于上市公司股东的净资产	10,582,787,885.23	5,423,131,165.33	95.14	4,148,183,267.04
经营活动产生的现金流量净额	1,832,059,827.37	576,258,618.29	217.92	1,482,436,862.52
基本每股收益（元／股）	0.8362	0.4559	83.42	0.4886
稀释每股收益（元／股）	0.8362	0.4559	83.42	0.4886
加权平均净资产收益率（%）	10.3388	8.0281	增加2.3107个百分点	10.6112
研发投入占营业收入的比例（%）	8.11	8.40	减少0.29个百分点	7.17

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,382,423,958.02	1,680,710,701.38	1,825,633,161.8	2,088,491,366.83
归属于上市公司股东的净利润	113,658,557.37	289,434,754.41	283,556,424.43	277,011,898.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,049,723.06	254,743,284.03	256,093,734.45	252,261,005.89
经营活动产生的现金流量净额	270,682,164.68	240,493,754.49	520,344,926.44	800,538,981.76

说明：公司第一季度受春节假期及疫情影响，销售收入占比较小，利润也较低。第四季度净利润比二、三季度略有下降，主要系年底计提奖金等各项费用较多。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位：股

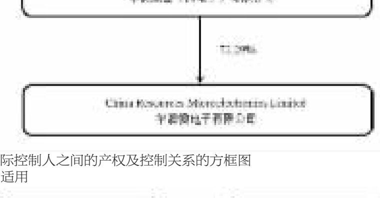
截止报告期末普通股股东总数(户)								51,587
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								50,024
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
华润集团（微电子）有限公司	0	878,982,146	72.29	878,982,146	878,982,146	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	78,125,000	6.43	78,125,000	78,125,000	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	9,496,360	9,496,360	0.78	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,946,019	4,946,019	0.41	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,866,536	4,866,536	0.40	0	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	4,000,000	4,000,000	0.33	0	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,720,006	3,720,006	0.31	0	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,658,674	3,658,674	0.30	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	2,900,000	2,900,000	0.24	0	0	无	0	境内非国有法人
白秀平	2,624,962	2,624,962	0.22	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知是否存在关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

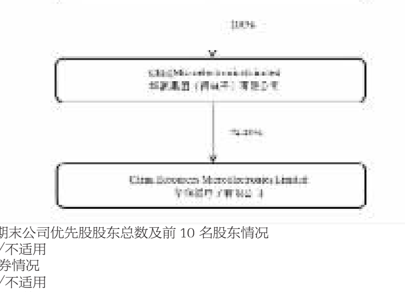
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入697,725.92万元，较上年同期增长21.50%；实现利润总额108,565.21万元，较上年同期增长114.58%；实现归属于母公司所有者的净利润96,366.16万元，较上年同期增长140.46%；报告期末公司总资产1,653,249.58万元，较期初增长63.76%；归属于母公司所有者权益为1,058,278.79万元，较期初增长95.14%。

（1）报告期内，公司营业收入较上年同期增长123,447.51万元，同比增长21.50%，主要系因功率器件事业群和代工事业群营业收入增加。

（2）报告期内，公司整体毛利率较上年同期增长4.63个百分点，主要系因公司单位成本下降、产品获利能力好于上年同期。

（3）报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长56,290.61万元，同比增长140.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长64,683.62万元，同比增长313.52%，主要系因公司营业收入同比增长21.50%、同时制造与服务业务板块产能利用率提升较大、毛利率提升4.63个百分点。

（4）报告期内，公司研发费用56,607.80万元，同比增长17.29%，公司新增境内专利申请319项，PCT国际专利申请54项，境外专利申请43项；公司新增获得授权专利215项。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）经本公司管理层批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	2020年12月31日预收款项列示金额0.00元， 合同负债列示金额232,783,137.57元； 2020年1月1日预收款项列示金额0.00元， 合同负债列示金额111,627,094.45元； 2020年度影响营业成本15,445,604.79元，影响销售费用-15,445,604.79元。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

1.本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	注册地／主要生产经营地	持股比例（%）		主营业务
			直接	间接	
1	华润微电子控股有限公司	上海		100	发行人境内运营实体的主要持股公司
2	无锡华润上华科技有限公司	无锡		100	从事晶圆制造业务
3	无锡华润微电子有限公司	无锡		100	从事辅助运营管理职能并持有部分境内运营公司的股权
4	华润微电子（重庆）有限公司	重庆		52.69	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
5	无锡华润华晶微电子有限公司	无锡		99.662	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
6	无锡华润安盛科技有限公司	无锡		100	从事公司半导体封装和成品测试业务
7	华润微集成电路（无锡）有限公司	无锡		100	从事集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
8	华润赛美科微电子(深圳)有限公司	深圳		100	从事晶圆测试和成品测试业务
9	重庆润芯微电子有限公司	重庆		50.9	持有矽磐微电子股权
10	矽磐微电子（重庆）有限公司	重庆		38.72	从事集成电路封装业务
11	无锡迪思微电子有限公司	无锡		100	掩模板的加工制造及销售
12	华润矽威科技(上海)有限公司	上海		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
13	华润半导体(深圳)有限公司	深圳		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
14	无锡华润芯功率半导体设计有限公司	无锡		100	分立器件销售
15	无锡华晶综合服务有限公司	无锡		100	负责发行人的仓储、食堂等后勤业务管理
16	润科投资管理（上海）有限公司	上海		51	投资管理，投资咨询
17	杰群电子科技（东莞）有限公司	东莞		70	从事半导体封装和成品测试业务
18	杰铨电子（东莞）有限公司	东莞		70	从事半导体电镀服务
19	Great Team Backend Foundry, (HK) Limited	中国香港		70	公司境外销售平台
20	InPower Semiconductor Company Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
21	CSMC Asia Limited	中国香港	100		公司境外销售平台
22	CSMC Manufacturing Co., Ltd.	英属维京群岛	100		公司境外销售平台
23	China Resources Semiconductor International Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
24	China Resources Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	持有发行人下属企业
25	Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
26	CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
27	Well-Known Property Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
28	Firstar Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
29	Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛		100	持有发行人下属企业
30	Well-Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港		100	无实际经营业务，持有物业
31	DIS Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	无实际经营业务
32	Bold Team Management Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
33	Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
34	Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
35	Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
36	Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
37	Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
38	Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务

2.本报告期内合并财务报表范围变化

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比新增加3家。

合并范围变更主体的具体信息详见“2020年年度报告中合并范围的变更”。

证券代码：688396　　证券简称：华润微　　公告编号：2021-020

华润微电子有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华润微电子有限公司董事会对2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144号文核准，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票292,994,049股（超额配售选择权行使前），募集资金总额375,032.38万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为367,320.13万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于2020年2月18日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年2月19日出具了天职业字[2020]7111号《验资报告》。2020年3月27日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行292,994,049股普通股的基础上额外发行43,949,000股普通股，本次发行的最终发行股数为336,943,049股，增加的募集资金总额为56,254.72万元，连同初始发行规模292,994,049股股票对应的募集资金总额375,032.38万元，本次发行最终募集资金总额为431,287.10万元。扣除发行费用合计为7,712.64万元，募集资金净额为423,574.46万元。保荐机构（主承销商）已于2020年4月1日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计56,254.72万元划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年4月2日出具了天职业字[2020]18408号《验资报告》。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金1,162,681,577.14元，募集资金余额为3,152,825,655.11元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，制定了《华润微电子有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构分别于2020年2月18日和2020年4月1日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司无锡华润上华科技有限公司连同保荐机构于2020年5月25日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，公司及公司全资子公司华润微电子控股有限公司连同保荐机构于2020年6月22日与兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、无锡华润微电子有限公司、无锡华润矽科微电子有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、华润矽威科技（上海）有限公司连同保荐机构于2020年8月25日分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行、兴业银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年12月31日止，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户人	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
华润微电子有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	NRA216200100102069965	42,729,121.96	募集专户、活期存款
无锡华润上华科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000840356	1,238,968,714.99	募集专户、活期及定期存款
无锡华润矽科微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893324	35,742,809.48	募集专户、活期存款
无锡华润安盛科技有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893059	3,888,960.02	募集专户、活期存款
无锡华润华晶微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893115	45,863,583.87	募集专户、活期存款
无锡华润微电子有限公司	宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000893268	11,401,116.40	募集专户、活期存款
华润微电子（重庆）有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行	3100025829100135058	16,406,350.64	募集专户、活期存款
华润矽威科技(上海)有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102417752	0.00	募集专户、活期存款
华润微电子控股有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	216200100102238256	1,757,824,997.75	募集专户、活期存款
	合计		3,152,825,655.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的8英寸高端传感器和功率半导体建设项目及产业并购及整合项目自筹资金共计人民币38,493.87万元。

2020年7月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2020年3月31日预先已投入募投项目中的前瞻性技术和产品升级研发项目自筹资金共计人民币1,602.86万元。

单位：万元 币种：人民币

先期投入项目	先期投入金额	募集资金置换先期投入金额	置换日期
8英寸高端传感器和功率半导体建设项目	25,797.19	25,797.19	2020年4月21日
产业并购及整合项目	12,696.68	12,696.68	2020年4月21日
前瞻性技术和产品升级研发项目	1,602.86	1,602.86	2020年7月28日
总计	40,096.73	40,096.73	

上述置换事项，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并分别于2020年4月2日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]19453号），于2020年7月27日出具了《华润微电子有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2020]33245号）。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（1）超额募集资金

2020年3月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金67,320.13万元用于产业并购及整合。2020年5月14日，公司召开2019年年度股东大会审议通过前述议案。

（2）全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金

2019年4月30日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。2019年5月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议同意前述议案。

2019年12月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议同意《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售募集资金投资项目的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股票，如发生前述情形，同意公司因增发股票而获得的超额配售募集资金拟全部用于产业并购及整合。2019年12月27日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议同意前述议案。

2020年3月30日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议同意《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权于2020年3月27日全额行使，发行总股数扩大至336,943,049股。因本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为56,254.72万元，在扣除发行费用后将全部用于产业并购及整合。

7、节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021年4月30日

（下转848版）

公司代码：688396　　公司简称：华润微

华润微电子有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会及董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人李虹、主管会计工作负责人彭庆及会计机构负责人（会计主管人员）吴从韵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,682,249,666.66	16,532,495,766.97	-5.14
归属于上市公司股东的净资产	10,528,708,879.02	10,582,787,885.23	-0.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	750,104,425.07	270,682,164.68	177.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,044,871,636.12	1,382,423,958.02	47.92
归属于上市公司股东的净利润	399,905,847.59	113,658,557.37	251.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,507,737.39	90,049,723.06	311.45
加权平均净资产收益率（%）	3.7616	1.6953	增加2.0663个百分点
基本每股收益（元／股）	0.3289	0.0935	251.76
稀释每股收益（元／股）	0.3289	0.0935	251.76
研发投入占营业收入的比例（%）	6.69	7.72	减少1.03个百分点

说明：

1、报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产下降，主要系受收购华润微电子（重庆）有限公司少数股东股权影响。因公司对华润微电子（重庆）有限公司少数股东股权收购价格大于购买日重庆公司少数股东权益账面价值，使公司资本公积减少4.55亿元，所以归属于上市公司股东的净资产下降。

2、经营活动产生的现金流量净额同比上升177.12%，主要系因市场景气度较高，客户回款较好。

3、报告期内公司营业收入上升47.92%，主要系因行业景气度较高，公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高。

4、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上升251.85%，主要系因收入上升以及毛利率上升。

5、报告期内，研发投入占收入比例较上年同期下降1.03个百分点，主要系收入上升幅度较大所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-374,189.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,943,190.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,264,966.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,594.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	1,795.31	
所得税影响额	-5,922,058.92	
合计	29,398,110.20	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							50,024
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华润集团（微电子）有限公司	878,982,146	72.29	878,982,146	878,982,146	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	6.43	0	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	14,689,474	1.21	0	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	6,500,900	0.53	0	0	无	0	境内非国有法人
中国中金财富证券有限公司	5,202,302	0.43	5,202,302	7,812,500	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,830,807	0.40	0	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,087,531	0.34	0	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	4,000,000	0.33	0	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,295,438	0.27	0	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,969,683	0.24	0	0	无	0	境内非国有法人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
前十名无限售条件股东持股情况			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	78,125,000	人民币普通股	78,125,000
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	14,689,474	人民币普通股	14,689,474
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	6,500,900	人民币普通股	6,500,900
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,830,807	人民币普通股	4,830,807
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,087,531	人民币普通股	4,087,531
全国社保基金五零三组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,295,438	人民币普通股	3,295,438
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,969,683	人民币普通股	2,969,683
白秀平	2,624,962	人民币普通股	2,624,962
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	2,427,569	人民币普通股	2,427,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司一季度经营状况保持稳定，整体业绩好于去年同期，营业收入同比增长47.92%，归属于上市公司股东的净利润同比增长251.85%，主要系因行业景气度较高，公司整体产能利用率较高，毛利率提升，产品获利能力好于去年同期。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2021年3月向重庆西永微电子产业园区开发有限公司支付14.44亿元，收购其所持有华润微电子（重庆）有限公司47.31%的股份。收购完成后，公司持有华润微电子（重庆）有限公司100%股份。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	华润微电子有限公司
法定代表人	李虹
日期	2021年4月30日